





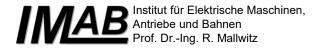
Grundlagen der Energietechnik Teil 3: Grundlagen der Leistungselektronik

Vorlesung (3)

Prof. Dr.-Ing. Regine Mallwitz Institut für Elektrischen Maschinen, Antriebe und Bahnen - IMAB

Was machen wir heute?

- 1. Einführung in die Leistungselektronik
 - 1.1. Aufgaben und Komponenten der Leistungselektronik
- 2. Leistungshalbleiter
 - 2.1. Bipolare Leistungshalbleiter: PN-Übergang, pn-Diode, Bipolartransistor, Thyristor, GTO
 - 2.2. Feldgesteuerte Leistungshalbleiter: MOSFET, IGBT
- 3. Netzgeführte Stromrichter (Stromrichterschaltungen mit Dioden und Thyristoren)
 - 3.1. Gleichrichter ungesteuert
 - 3.1.1 Mittelpunktschaltungen: M1U, M2U, M3U
 - 3.1.2. Brückenschaltungen: B2U, B6U
 - 3.2. Gleichrichter gesteuert
 - 3.2.1. M1C, M2C, M3C, B2C, B6C
- 4. Selbstgeführte Stromrichter (Stromrichterschaltungen mit MOSFET und IGBT)
 - 4.1. Gleichstromsteller
 - 4.1.1. Tiefsetzsteller
 - 4.1.2. Hochsetzsteller
 - 4.1.3. Zweiquadrantensteller
 - 4.1.4. Vierquadrantensteller (Vollbrücke)
 - 4.2. Umrichter
 - 4.2.1. Umrichter mit Gleichspannungs-Zwischenkreis (ein- und dreiphasig)



Komponenten der Leistungselektronik

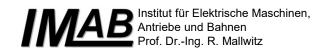
- Moderne Leistungshalbleiter:
 - Diode
 - Thyristor
 - GTO
 - IGBT
 - MOSFET
- Treiber für die steuerbaren Halbleiter

> Aktive Komponenten

- Widerstände, NTC-Widerstände, Varistoren
- Kondensatoren
- Drosseln
- Transformatoren, Übertrager
- Filter (EMV, du/dt-, Sinus-Filter)
- Messstellen

> Passive Komponenten

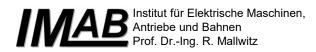




Leistungshalbleiter lassen sich nach *Art der Ansteuerung* (Steuerelektrode) einteilen:

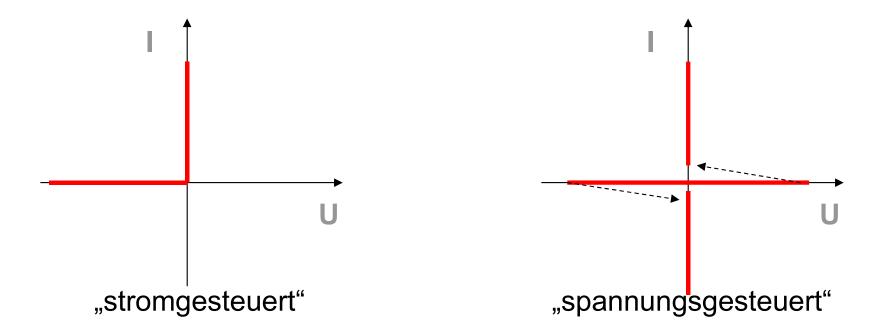
- (1) keine Steuermöglichkeit über eine Steuerelektrode
 - ▶ Diode
- (2) steuerbar *über eine Steuerelektrode*
 - a) nur einschaltbar (und in eine Richtung durchlässig = unidirektional):
 - ▶ gesteuerte Hg-Dampfgleichrichter, ▶ Thyratron,
 - **►** Thyristor
 - b) nur einschaltbar (und in zwei Richtungen durchlässig = bidirektional):
 - ▶ getriggerte Funkenstrecken,
 ▶ Triac
 - c) ein- und ausschaltbar (und in eine Richtung durchlässig = unidirekt.):
 - ► Crossatron,
 - ▶ Bipolartransistor, ▶ GTO-Thyristor (gate turn off), ▶ IGCT (integrated gate commutated thyristor),
 - ► MOSFET (metal oxide silicon field effect transistor), ► IGBT (insulated gate bipolar transistor)





Leistungshalbleiter lassen sich nach <u>Art der Ansteuerung</u> (<u>Spannung</u>, <u>Strom</u>) einteilen:

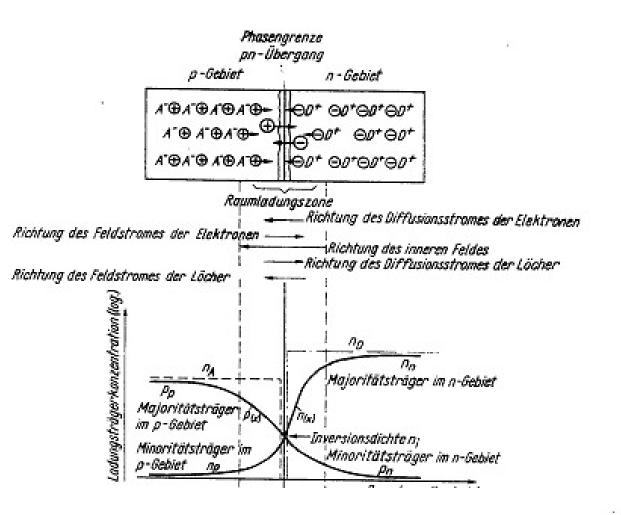
- → gesteuert durch angelegte Spannung oder eingeprägten Strom:
 - Gleichrichter-Dioden (stromgesteuert)
 - Funkenstrecken, DIAC, TRANZORB (spannungsgesteuert)

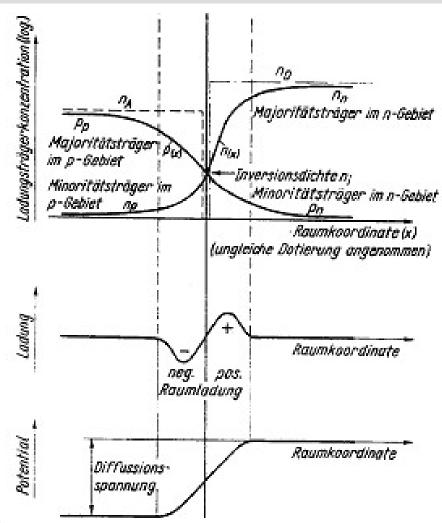






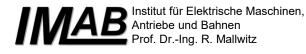
pn – Übergang ohne angelegte äußere Spannung



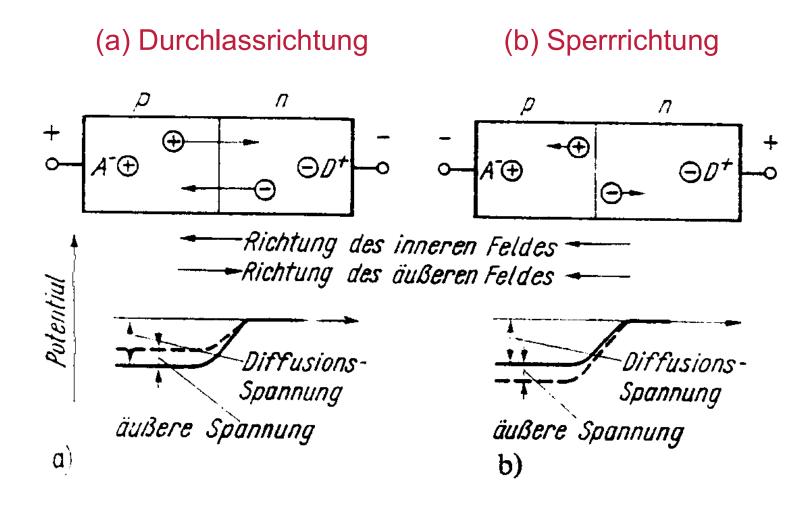


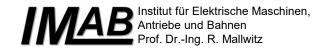
→ beim Ladungstransport, muss eine Potenzialbarriere überwunden werden!



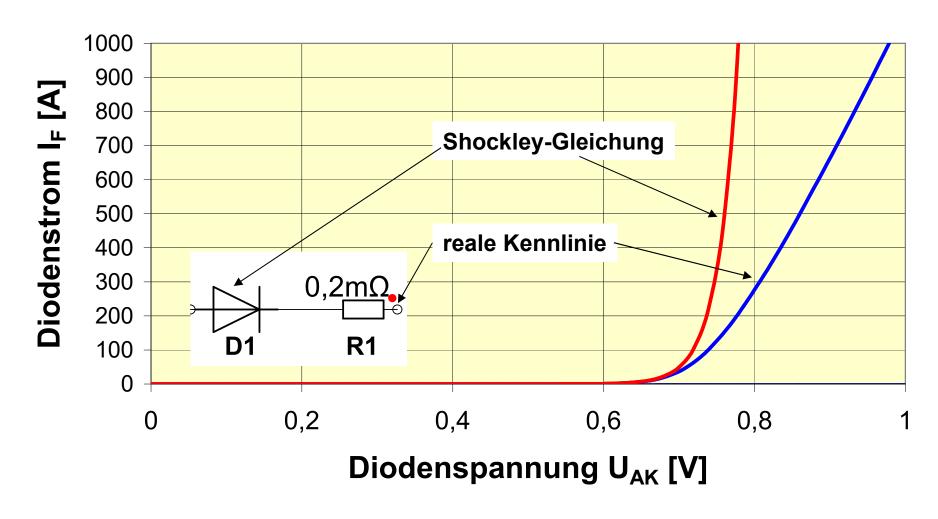


pn – Übergang mit äußerem Feld



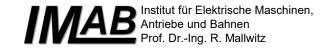


Durchlasskennlinie einer Siliziumdiode

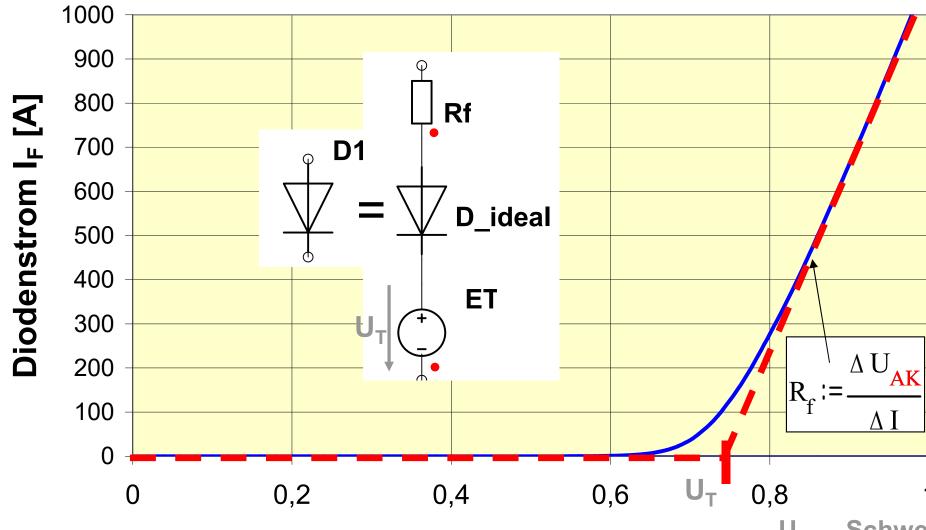


 $R_1 = R_F \dots Bahnwiderstand$





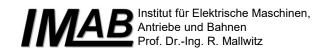
Durchlasskennlinie einer Siliziumdiode



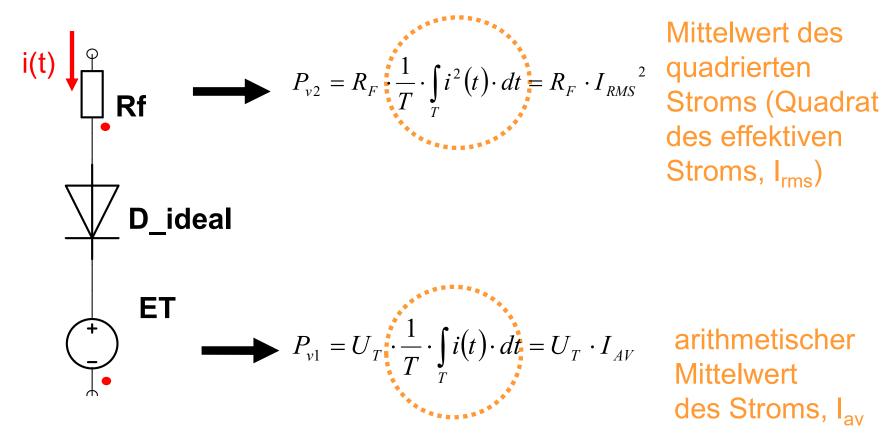
Diodenspannung U_{AK} [V]

U_T ... Schwellenspannung (threshold voltage)





Durchlassverluste

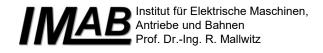


Mittelwert des des effektiven Stroms, I_{rms})

des Stroms, Iav

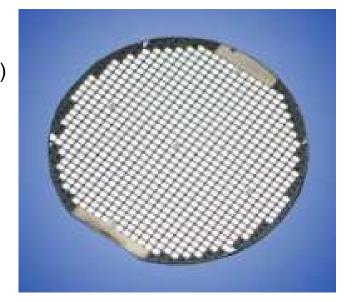
→
$$P_{Vges} = P_{V1} + P_{V2} = U_{T} \cdot I_{av} + R_{f} \cdot I_{rms}^{2}$$





Beispiele für moderne Leistungshalbleiter (eupec/Infineon)

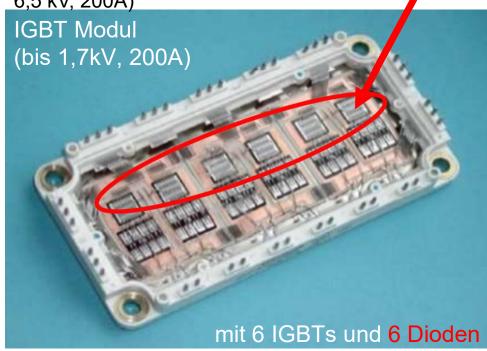
Silizium-Scheibe (auch: Wafer, max. Ø heute: 450mm)





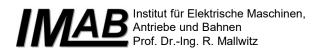
Scheibenzellen für große Leistungen (Dioden, Thyristoren bis 9kV, 6kA)

Aus den Scheiben prozessierte viereckige Chips für kleine Leistungen (max. bis. ca. 14 mm x 14 mm / 6,5 kV, 200A)

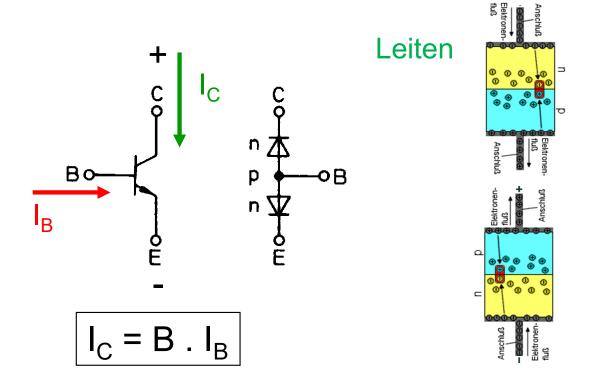






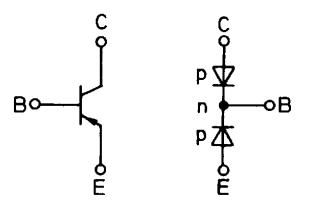


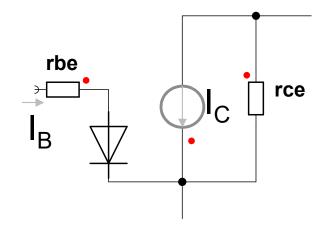
Bipolarer Transistor (BJT, bipolar junction transistor)



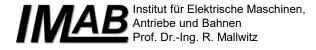


→ Im Schaltbetrieb muss der Basisstrom genügend groß sein, damit der Transistor nicht strombegrenzend mit hohen Spannungsabfällen wirkt!

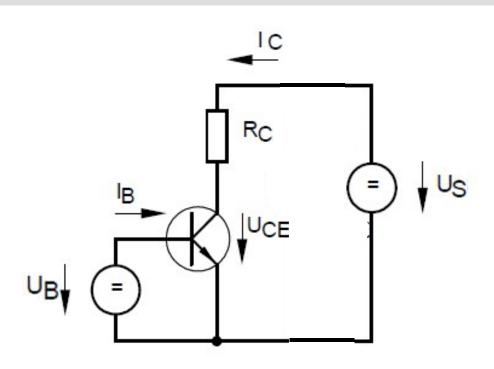


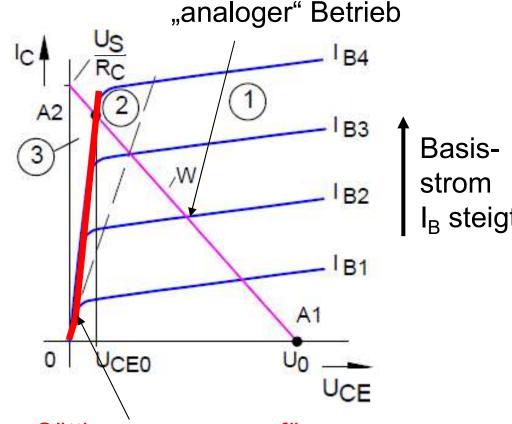






Bipolarer Transistor: Betrieb mit Last und Kennlinien



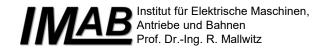


- (1) Linearer (oder "analoger") Bereich
- (2) Quasi-Sättigung
- (3) Sättigung

Sättigungsspannung für "Schaltbetrieb"

Stromverstärkung für Leistungstransistoren $I_{cmax}>5A$: **B** = 1...30

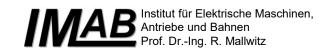




Bipolare Transistoren in der Leistungselektronik

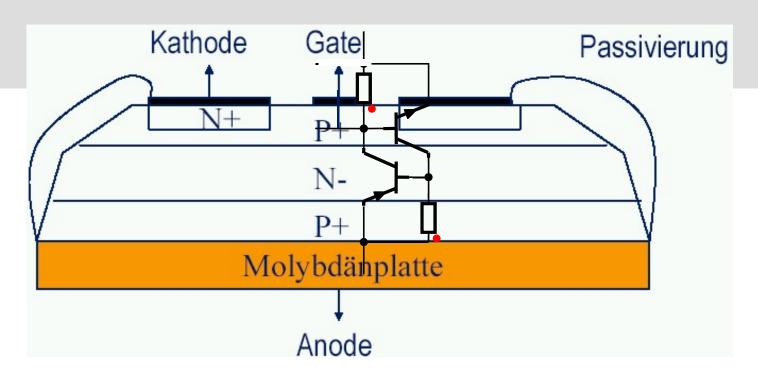
- relativ hohe Ansteuerleistung
- hohe Speicherzeiten durch Sättigung
- geringe Sättigungsspannung (0,3...0,5V pro Transistor)
- empfindlich gegenüber Überströmen
- Einsatz nur noch bei kleineren
 Spannungen und kleineren
 Leistungen von bis zu einigen 100W
 mit weiter fallender Tendenz

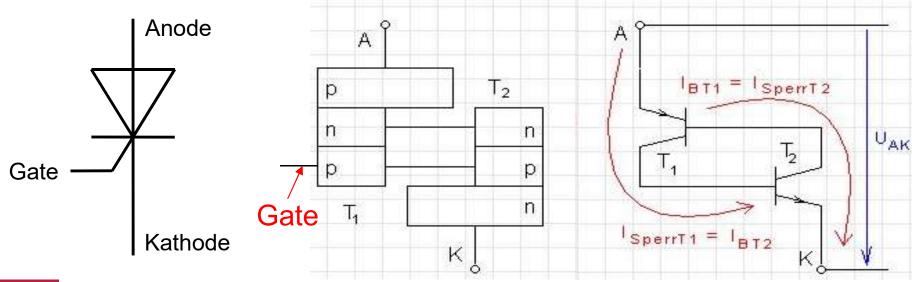




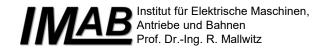
Thyristor:

Ein 4-Schicht-Bauelement



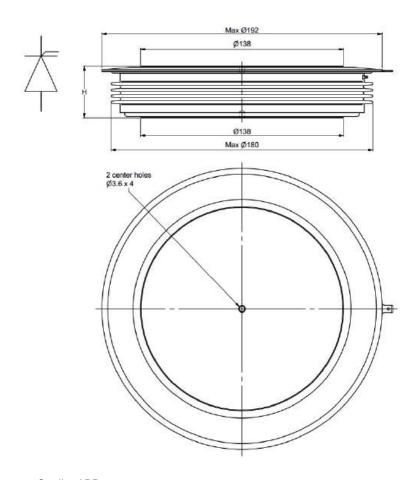






Bauform: Scheibenthyristoren

(für hohe Spannungen bis ca. 8kV und Ströme bis ca. 6kA, bis ca. 180mm Durchmesser)

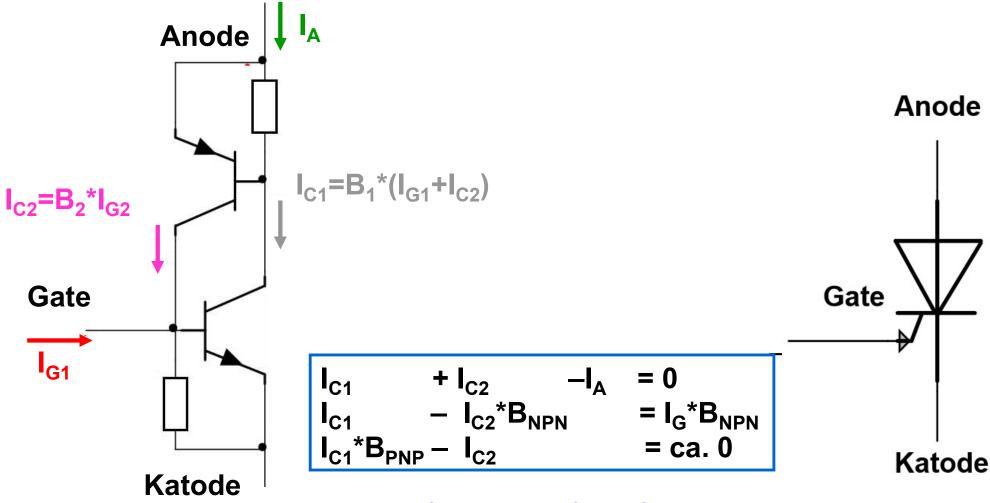


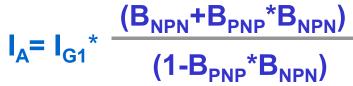


Quelle: ABB



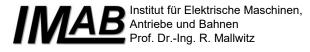
Der Thyristor



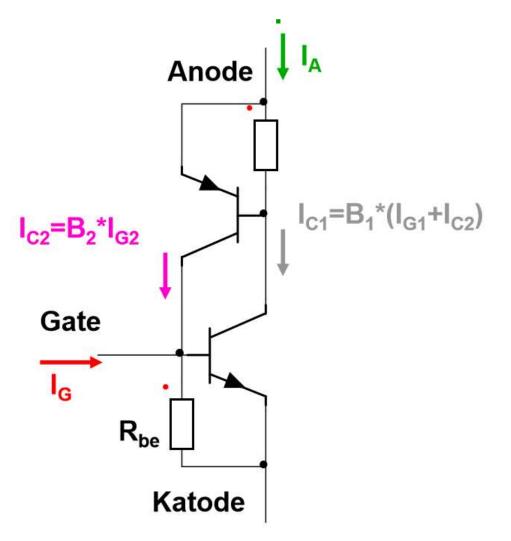








Thyristor: Haltestrom

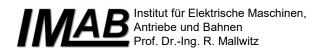


Überschlägige Erfüllung der Bedingung B_{NPN}*B_{PNP}≥1 bei U_{BE}=0,7V

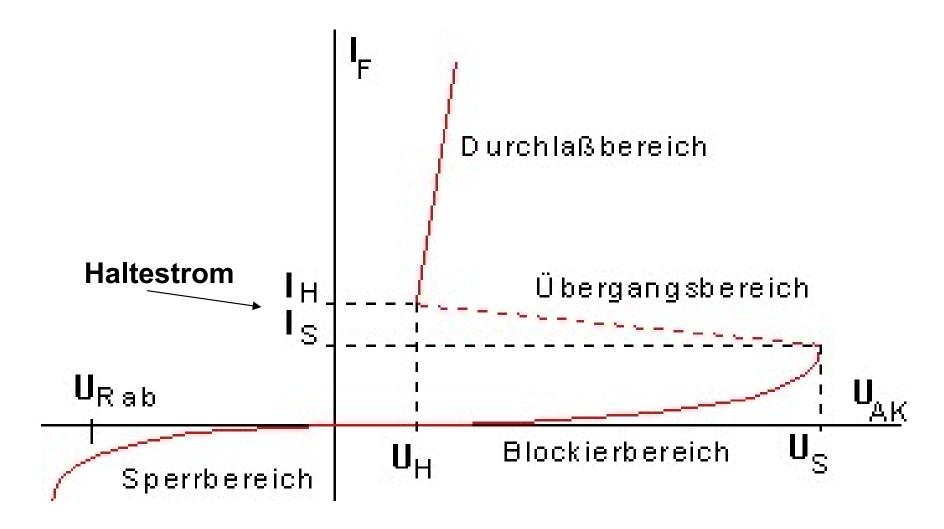
→ minimaler Strom für stabilen eingeschalteten Zustand:

Haltestrom: I_H=0,7V/R_{be}

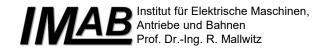




Thyristor: Kennlinie



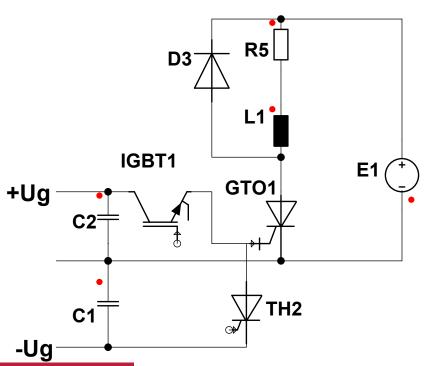


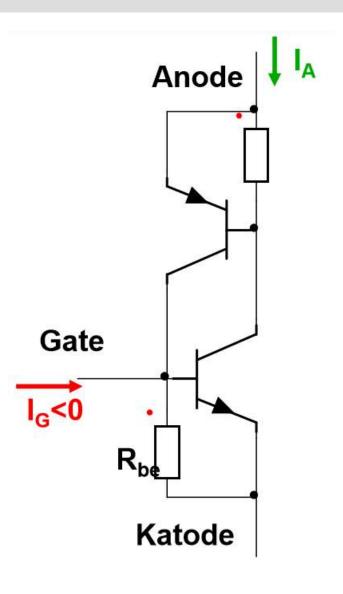


GTO – Thyristor (Gate Turn Off)

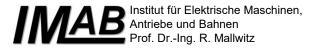
Aus der Ersatzschaltung ergibt sich auch die Möglichkeit des Abschaltens bei $I_G = -I_A$

→ Erfordert eine feine Gatestruktur zum Erreichen der gesamten aktiven Fläche

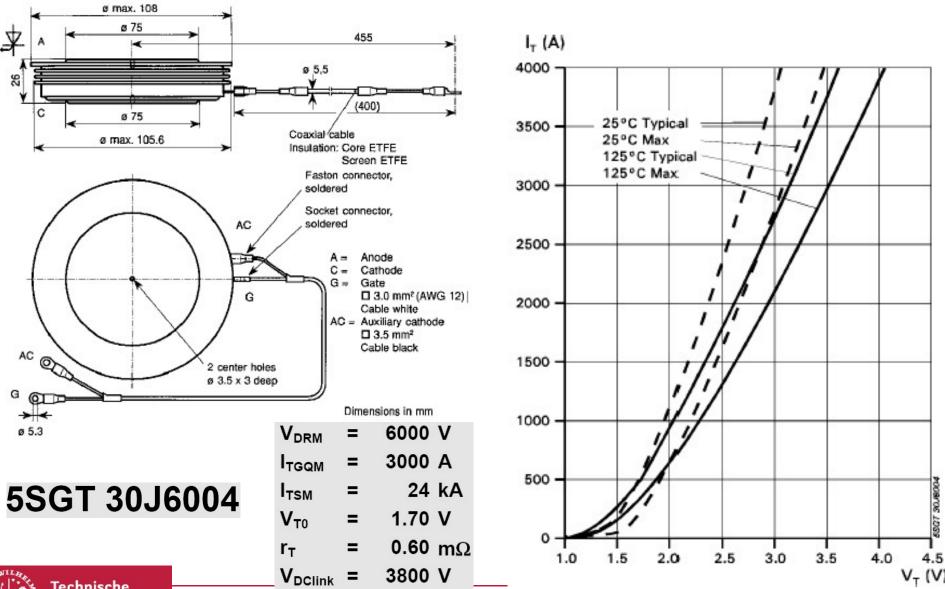






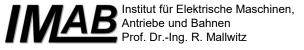


GTO – Thyristor, ABB

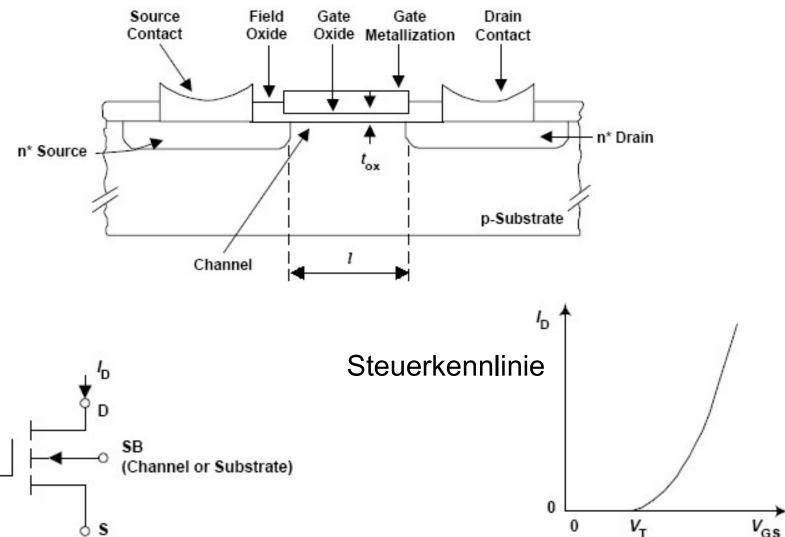




Folie 21 | VL03 – GENT - Leistungselektronik

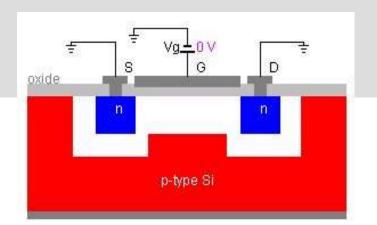


MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)

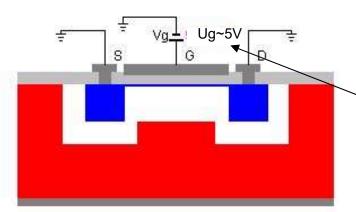


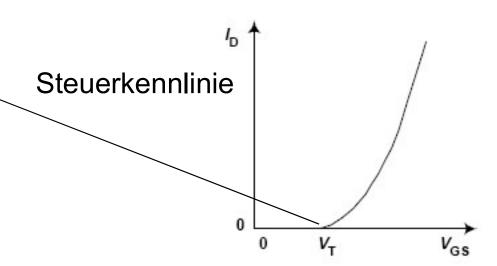


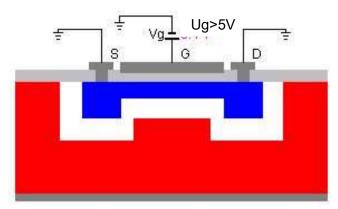




Ausbildung eines leitfähigen Kanals beim MOSFET

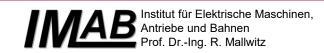






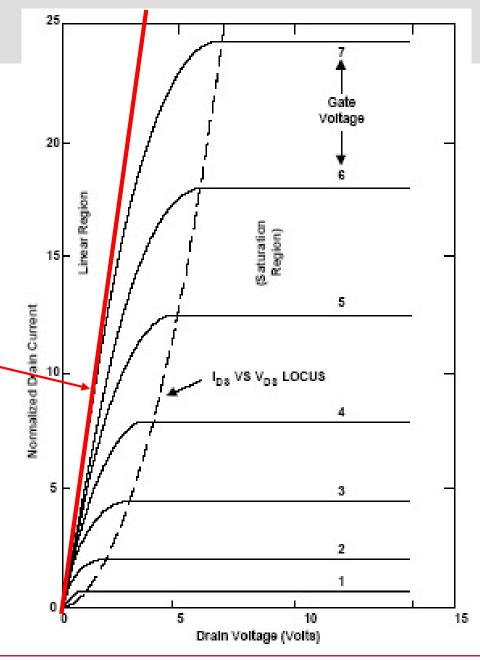
→ der Strom durchfließt nur Bereiche eines Trägertyps



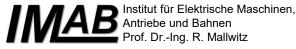


Ausgangskennlinie eines MOSFET

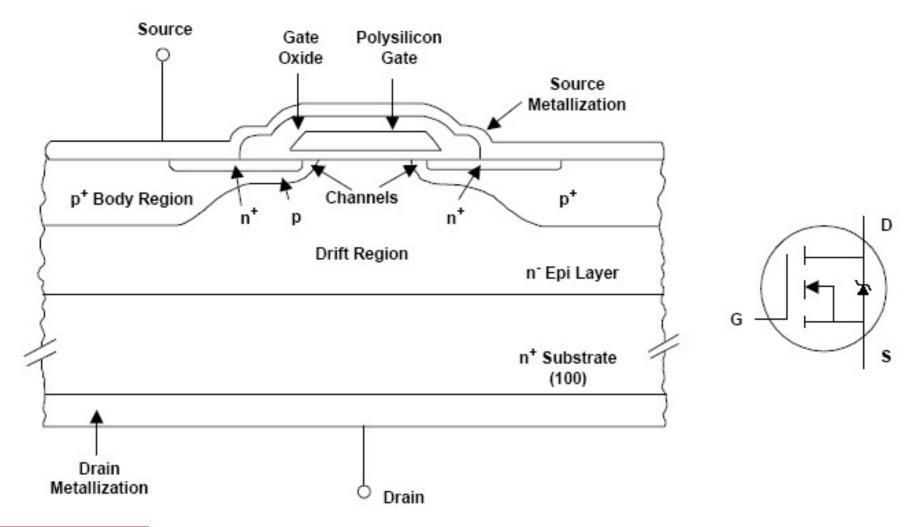
MOSFET's verhalten sich im eingeschalteten Zustand wie Widerstände!



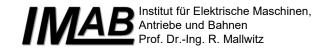




Vertikale Struktur eines n-Kanal-Leistungs-MOSFET's



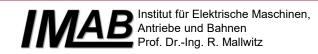




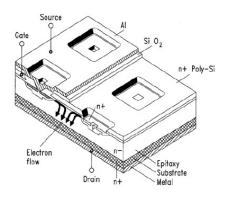
Eigenschaften von MOSFETs

- Im **Durchlass** ist der MOSFET durch eine Widerstandscharakteristik bestimmt. Der Durchlasswiderstand R_{DSon} bestimmt den Spannungsabfall und damit die Verluste des MOSFETs.
- Die **Steuerung erfolgt stromlos**. Die Spannung U_{GE} zwischen Gate und Emitter ist im statischen Betrieb konstant und es fließt nahezu kein Strom über die Gate-Emitter-Strecke.
- Der MOSFET zeichnet sich durch im Vergleich zu Bipolartransistoren und IGBTs sehr geringe Schaltzeiten und geringe Schaltverluste aus.
- Der MOSFET besitzt strukturbedingt eine inhärente Diode.
- (Silizium-)MOSFETs sind verfügbar für einen breiten Leistungsbereich bis zu maximalen Sperrspannungen von ca. 1.000V. Dies ist geringer als bei Bipolartransistoren und IGBTs.
- MOSFETs werden eingesetzt in selbstgeführten Schaltungen und sind die heute üblichen Leistungsschalter, z.B. in Schaltnetzteilen, Batterieladegeräten, Wechselrichtern bzw. Umrichter kleinerer Leistung.



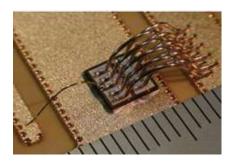


Ausführungsbeispiel



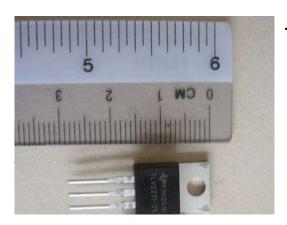
Planare, vertikale MOSFET-Struktur – Schnitt durch einen Chip

source: R. Bayerer, Infineon

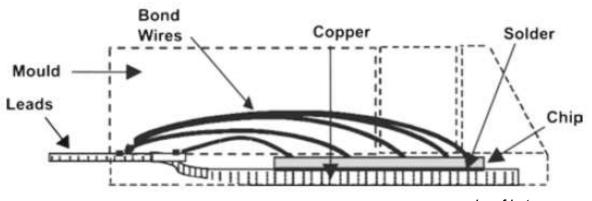


SiC - MOSFET (Chip)

source: Rohm

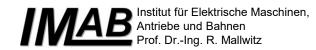


TO 220 - Gehäuse



source: Josef Lutz

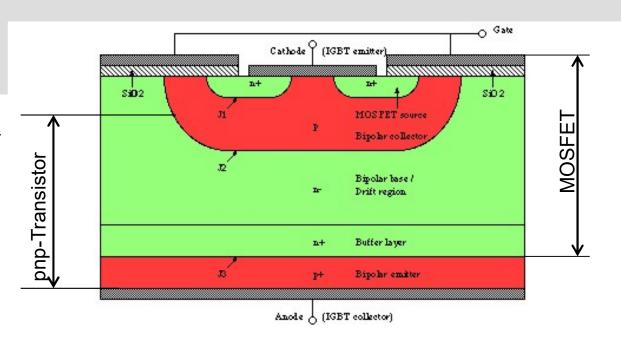




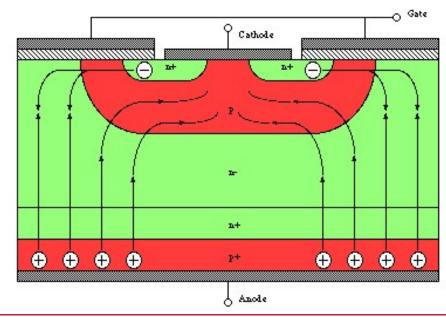
IGBT

<u>I</u>nsulated <u>G</u>ate <u>B</u>ipolar <u>T</u>ransistor

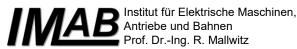
→ Feldgesteuertes
Bauelement mit bipolarer
Struktur

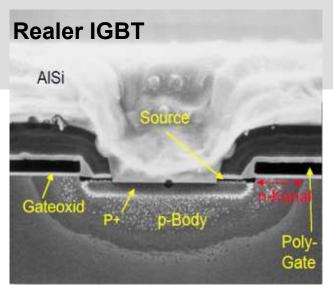


→ Strom von Elektronen und Löcher

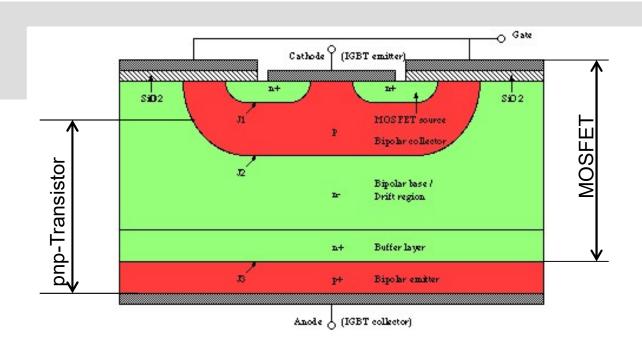


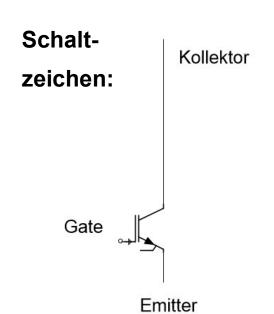


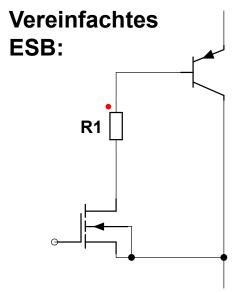


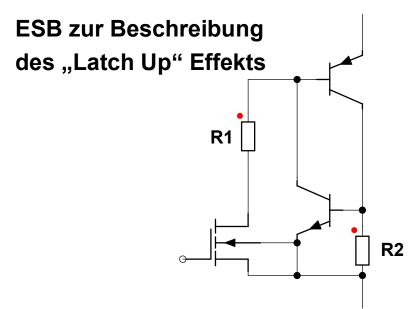


n-Source-Breite ca. 1,5μm, p-Body-Breite ca. 7 μm











Ausgangskennlinie eines IGBT

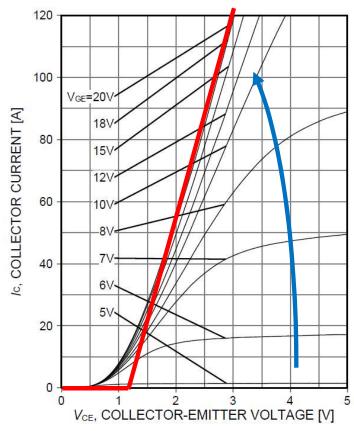
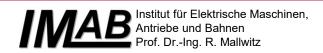


Figure 5. **Typical output characteristic** (T_{vi} =150°C)

- Die Kennlinien entsprechen denen eines bipolaren Bauelements wie Diode oder Bipolartransistor.
- Der Collector-Strom wird über die Gate-Emitter-Spannung gesteuert.

- Typische Werte für die Durchlassspannung bei Nennstrom liegen bei ca. 1,5 V bis 3 V.
 Im Beispiel mit dem Nennstrom 40A sind es 1,7V.
 - → Diese hohe Werte machen IGBTs für niedrige Einsatzspannungen uninteressant.



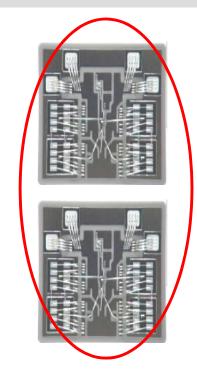


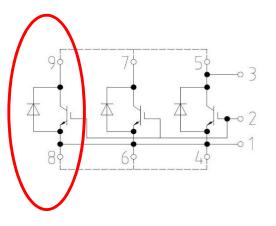
Beispiel: Aufbau eines Hochstrom-IGBT-Moduls

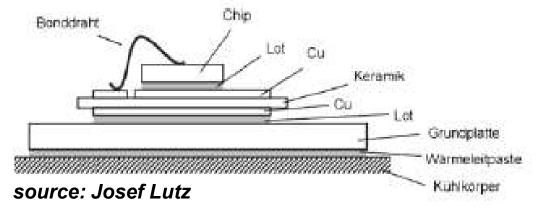


source: Infineon AG

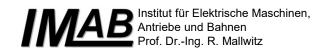
 Leistungsmodule zur Erhöhung der Stromtragfähigkeit (bis ca. 3kA)











Eigenschaften von IGBTs

Durchlassverhalten wie ein Bipolartransistors

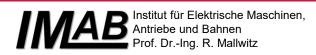
Die Durchlassverluste sind bei hohen Strömen kleiner gegenüber vergleichbaren MOSFETs mit hohen Sperrspannungen.

- Im Vergleich zum MOSFET treten höhere Schaltverluste auf.
 Zwei Arten von Ladungsträgern führen den Strom, was beim Abschalten zu einem Tailstrom führt.
- Geringe Ansteuerverluste:
 Der IGBT wird wie ein (MOS)FET spannungsgesteuert.
- Hohe Spannungs- und Stromgrenzen:
 Sperrspannungen 600V bis 6500 V
 Ströme bis 200A (Einzelchip) / 4.000A (Modul)
- Rückwärts-Sperrfähigkeit nur begrenzt gegeben Verwendung einer (zusätzlichen) Freilaufdiode mit kurzen Schaltzeiten zwischen Emitter und Kollektor, die in Rückwärtsrichtung leitet, notwendig.

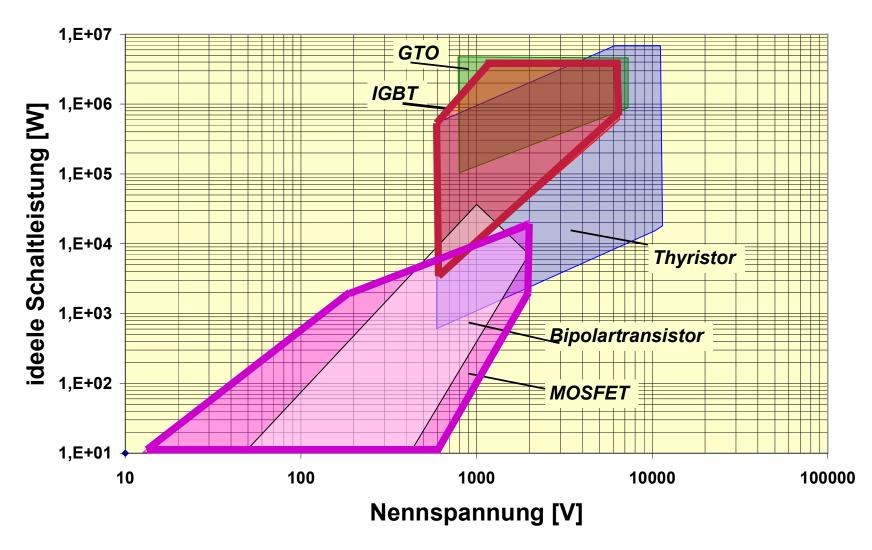


■ Einsatz: IGBTs werden wie MOSFETs eingesetzt in selbstgeführten Schaltungen. Sie sind die heute üblichen Leistungsschalter, z.B. in Antriebs- und Wechselrichtern größerer Leistungen, Backto-Back-Konvertern in Windenergieanlagen und der Hochspannungsgleichstromübertragung, ...

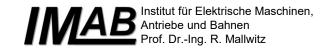




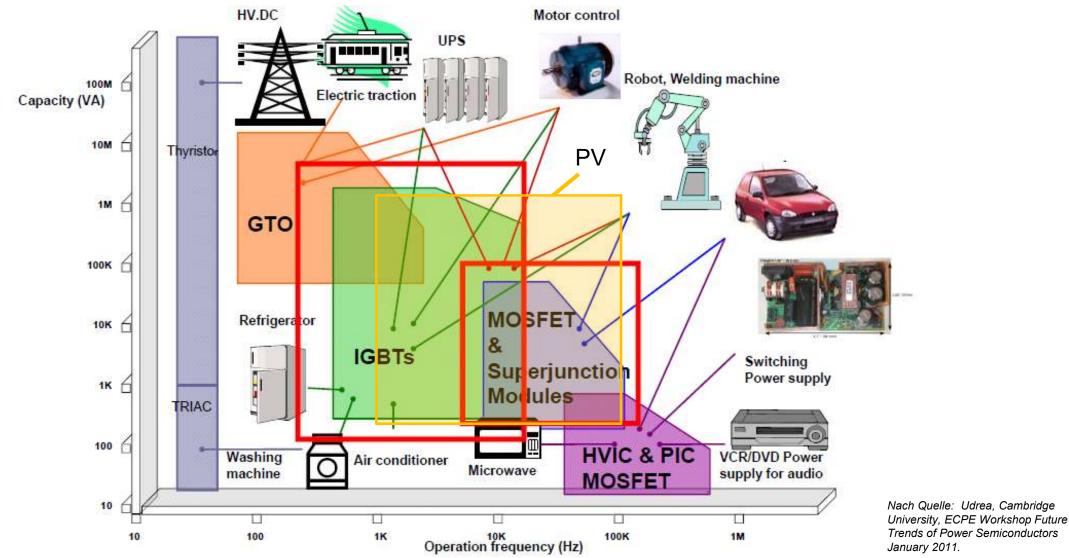
Grenzen leistungselektronischer Schalter

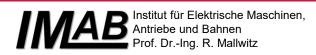






Einsatzbereiche von Leistungshalbleitern





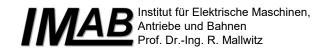
Was haben wir heute gemacht?

- Leistungshalbleiter
 - Bipolare Leistungshalbleiter: Diode, Bipolartransistor, Thyristor, GTO
 - Feldgesteuerte Leistungshalbleiter: MOSFET, IGBT

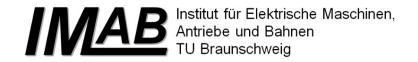
Was kommt in der nächsten Vorlesung?

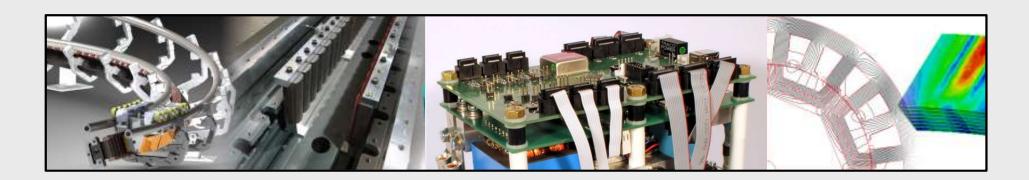
- Gesteuerte Gleichrichter
 - M1C, M2C und M3C











Leistungselektronik @ Institut für Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen

Prof. Dr.-Ing. Regine Mallwitz (Leistungselektronik)

M: r.mallwitz@tu-braunschweig.de

T.: + 49 (0)531 3913901

M.Sc. Cengiz Uzlu

M: c.uzlu@tu-braunschweig.de

T.: + 49 (0)531 3913917

M.Sc. Robert Rohn

M: r.rohn@tu-braunschweig.de

T.: +49 (0)531 3918165

www.imab.de





